KINOSHII A et al Q63469.
BASE FR M FOR MEDICAL ADHESIVE LAPE, AND MI DICAL ADHISIVE FAPE, ADHESIVE PLASTER AND FIRST-AID ADHISIVE FAPE PRODUCED USING THE FILM FILED April 11, 2001.
Mark Boland. (2021-293-7060)

 $1 \, \cot \, 1$

日本国特許庁

PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT

11000 U.S. PTO 09/829985

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日

Date of Application:

2000年 4月20日

出願番号

Application Number:

特願2000-119987

出 顧 入 Applicant (s):

日東電工株式会社

2001年 1月26日

ommissione.
Patent Office



特2000-119987

【書類名】

特許願

【整理番号】

0000602

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

A61F 13/00

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府茨木市下穂積1丁目1番2号

日東電工株式会社内

【氏名】

木之下 隆士

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府茨木市下穂積1丁目1番2号

日東電工株式会社内

【氏名】

濱田 昌志

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府茨木市下穂積1丁目1番2号

日東電工株式会社内

【氏名】

渡辺 哲男

【発明者】

【住所又は居所】

大阪府茨木市下穂積1丁目1番2号

日東電工株式会社内

【氏名】

白井 文哉

【特許出願人】

【識別番号】

000003964

【氏名又は名称】 日東電工株式会社

【代理人】

【識別番号】

100104307

「分班 」

. 八名人成石柳。 1111

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 043982

特2000-119987

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 9601993

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 貼付材用基材フィルム及びこれを用いた貼付材、絆創膏並

びに救急絆創膏

【特許請求の範囲】

【請求項1】 非晶性ポリオレフィンよりなるA層の少なくとも片面に、ポリプロピレン系樹脂よりなるB層を積層したことを特徴とする貼付材用基材フィルム。

【請求項2】 前記B層は、熱可塑性エラストマーを含有することを特徴と する請求項1記載の貼付材用基材フィルム。

【請求項3】 前記A層のいずれか一方の露出面に、熱可塑性エラストマーを含有するB層が積層され、残る一方の露出面には、熱可塑性エラストマーを含有しないB層が積層されたことを特徴とする請求項2記載の貼付材用基材フィルム。

【請求項4】 前記非晶性ポリオレフィンは、非晶性ポリプロピレン、エチレン及び/又はブテン-1とプロピレンとのランダム共重合体の何れか1種若しくは2種以上であることを特徴とする請求項1~3の何れか1項に記載の貼付材用基材フィルム。

【請求項5】 前記A層が結晶性ポリオレフィンを含有することを特徴とする請求項1~4の何れか1項に記載の貼付材用基材フィルム。

【請求項6】 前記A層が熱可塑性エラストマー及び無機充填剤を含有することを特徴とする請求項1~5の何れか1項に記載の貼付材用基材フィルム。

【請求項7】 前記熱可塑性エラストマーは、エチレンーブテン共重合体及び/又はスチレンーブタジエン共重合体であることを特徴とする請求項2~6の何れか1項に記載の貼付材用基材フィルム。

【請求項8】 前記B層におけるポリプロピレンが、エチレンを含有するラ
ゼンゼンブ・ベンス ベキマーン た物徴しまで 唐東南 ニーニ かがまり 三面 上記載 am 何 付用基材 こここ

【請求項9】 前記B層の露出表面がエンボス加工されていることを特徴と する請求項1~8の何れか1項に記載の貼付材用基材フィルム。 【請求項10】 前記A層の厚みが、 $10\sim100\mu$ mであることを特徴とする請求項 $1\sim9$ の何れか1項に記載の貼付剤用基材フィルム。

【請求項11】 前記B層の厚みが、 $2\sim20~\mu$ mであることを特徴とする 請求項 $1\sim10$ の何れか1項に記載の貼付材用基材フィルム。

【請求項12】 貼付材用基材フィルムの少なくとも片面に、粘着剤層を備えた貼付材において、

前記貼付材用基材フィルムは、請求項1~11の何れか1項に記載の貼付材用 基材フィルムであって、前記粘着剤層は、前記B層に直接的若しくは間接的に積 層したことを特徴とする貼付材。

【請求項13】 前記粘着剤層は、前記熱可塑性エラストマーを含有するB 層側に積層されたことを特徴とする請求項12記載の貼付材。

【請求項14】 前記粘着剤層の厚みは、10~120μmであることを特徴とする請求項12又は13記載の貼付材。

【請求項15】 前記貼付材用基材フィルムに粘着剤層を備えた貼付材が巻回されてなる絆創膏であって、

前記貼付材は、請求項12~14の何れか1項に記載の貼付材であることを特 徴とする絆創膏。

【請求項16】 前記貼付材用基材フィルムに粘着剤層を備えた貼付材と、 前記粘着剤層の中央領域に吸液性パッドを備えた救急絆創膏であって、

前記貼付材は、請求項12~14記載の何れか1項に貼付材であることを特徴とする救急絆創膏。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

[0002]

【従来の技術】

救急絆創膏や巻絆創膏など、医療用途の貼付材に用いられる支持体用のフィルムとして、従来より、カレンダー法やキャスティング法により作製された可塑化ポリ塩化ビニルを主成分としたフィルムが数多く使用されてきた。

[0003]

この可塑化ポリ塩化ビニルを主成分としたフィルムは、引張初期における高い 応力が、引っ張ったままにしておくと、時間と共に急激に応力が緩和するという 特性を有している。このような特性を有するフィルムを用いた貼付材を皮膚に貼付した場合には、貼付後次第に引張応力が緩和され、皮膚への負担が軽減される 結果となる。

[0004]

しかし、近年、上記可塑化ポリ塩化ビニルの使用については、使用しているフタル酸系被状可塑剤や含有する塩素による環境問題の観点からその対策が求められている。また、一般に軟質ポリ塩化ビニルは、柔軟性を付与するために、液状の可塑剤が多量に配合されており、この可塑剤が粘着剤中に移行して粘着剤層の凝集力を低下させ、いわゆる糊残り現象が生じたり、粘着力が低下するなどの問題を引き起こすとの指摘もあった。

[0005]

このため、医療用途においてはもちろんのこと、その他の分野においても、ポリ塩化ビニルに替わる材料として、柔軟でかつ伸縮性を有する熱可塑性樹脂の開発が活発に行なわれている。

[0006]

[0007]

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、このような樹脂を用いた単独フィルムやブレンドフィルムを用いた場合では、耐熱性、引張強度、柔軟性、応力緩和性などにおいてバランスのとれた軟質ポリ塩化ビニル(可塑化ポリ塩化ビニル)フィルムを用いた貼付材の特性には、未だ十分には到っていないのが現状である。

[0008]

本発明は、上記従来技術の問題点に鑑みてなされたものであって、引張強度、 柔軟性並びに応力緩和性などにおいてバランスのとれた特性を有する軟質ポリ塩 化ビニルフィルムの代替となる新たな貼付材用基材フィルムを提供することを目 的とするものである。

[0009]

そこで、本発明者らは、鋭意研究を重ねた結果、支持基材として非晶性ポリオレフィンフィルムを用いた多層フィルムが、引張強度、柔軟性並びに応力緩和性において軟質ポリ塩化ビニルフィルムに近い特性を有することを見い出した。さらに、このようなフィルムにおいては、フィルム中に含有され、柔軟性に寄与する低分子量物の表面ブリードをも抑えることが可能なことを見い出し、本発明を完成させるに至った。

[0010]

【課題を解決するための手段】

本発明に係る貼付材用基材フィルムは、非晶性ポリオレフィンよりなるA層の少なくとも片面に、ポリプロピレン系樹脂よりなるB層を積層したことを特徴としている。すなわち、本発明の貼付材用基材フィルムは、少なくとも2層構造をしており、非晶性ポリオレフィンよりなるフィルム(A層)とポリプロピレン系樹脂よりなるフィルム(B層)を積層したものであって、さらには、前記A層のの原本時間、フェッキーをトラーであって、さらには、前記A層の

本発明の貼付材用基材フィルムのベース層(A層)は、非晶性ポリオレフィンを主成分とするものであって、必要に応じて非晶性ポリオレフィンに、無機充填

剤や高分子可塑剤を含有させて作製される。

[0012]

当該非晶質ポリオレフィンとしては、例えば、特開平4-224809号公報に開示された方法により得られるものや、特公平6-89071号公報等に記載されたものが例示される。より具体的には、所定の触媒を用いて、プロピレンを単独でアタクチック重合させたもの、プロピレンとプロピレン以外の炭素数2~10のα-オレフィンとを各モノマーがランダムに配列するように共重合させた分子量の比較的低いものが挙げられ、後者においては、プロピレン含量が50重量%以上であり、炭素数2~10のα-オレフィン含量が50重量%以下のものが好ましく用いられる。

[0013]

当該 αーオレフィンとしては、エチレン、ブテンー1、ペンテンー1、ヘキセンー1、オクテンー1、ノナンー1、デセンー1、4ーメチルペンテンー1、4ーメチルペキセンー1、4・4ージメチルペンテンー1などの鎖状αーオレフィンや、シクロペンテン、シクロヘキセンなどの環状αーオレフィンを挙げることができる。これらのαーオレフィンは、1種若しくは2種以上を適宜組み合わせて用いることもできる。また、上記した中でも、非晶性のプロピレン重合体、非晶性のエチレン及び/又はブテンー1とプロピレンとの共重合体、すなわち、エチレンとプロピレンとの共重合体、あるいはブテンー1とプロピレンとの共重合体、さらにはエチレンとブテンー1及びプロピレンとのランダム共重合体が特に望ましく用いられる。なお、本発明においては、非晶性ポリオレフィンは、非晶性のポリオレフィンだけではなく、本発明の効果を発揮できる限りにおいて、低結晶性のポリオレフィンをも含む概念である。

[0014]

また、これらの非晶性ポリオレフィンとしては、数平均分子量が1,000~

100~100, 000mPa·Sの比較的低粘度のものが好ましく用いられる

[0015]

このように、従来のポリプロピレン系樹脂に比べて結晶質部分の割合を大幅に 減らした非晶性若しくは低結晶性ポリオレフィンを用いることにより、貼付材基 材フィルムの応力緩和性や柔軟性を高めることができる。

[0016]

さらに本発明にあっては、弾性率や伸びなどの物理的性質を調整するために、結晶性のポリプロピレン系樹脂を適宜混合して用いることもできる。このときの混合比としては、非晶性(低結晶性)ポリオレフィンを5~95重量%、好ましくは10~90重量%、さらには好ましくは20~80重量%となるように調整するのが好ましい。非晶性(低結晶性)ポリオレフィンが5重量%未満であれば、得られた貼付材用基材フィルムの柔軟性が低下する傾向を示し、本発明の用途には適しにくくなる。

[0017]

また、貼付材用基材フィルムに軟質フィルムの特性を持たせるため、混合する結晶性ポリプロピレンとして、密度 0.890 g/c m 3 以上、好ましくは 0.895 g/c m 3 のプロピレン系ランダム共重合体を用いるのが特に好ましい。

[0018]

さらに本発明においては、非晶性(低結晶性)ポリオレフィンや結晶性ポリプロピレンとして、変性したものを用いることもできる。当該変性ポリオレフィンとしては、上記非晶性(低結晶性)ポリオレフィンや結晶性ポリオレフィンを、アクリル酸、メタアクリル酸、マレイン酸、フマル酸、イタコン酸などの不飽和カルボン酸、これらのエステル、これらの酸無水物、これらの金属塩、さらにはこれらの誘導体を用いて変性したものを用いることができる。

[0019]

イ酸化合物が挙げられる

[0020]

この中で、本発明においては、ゼオライト及びタルクは、他のケイ酸化合物に 比べ、当該A層のフィルムの剛性を挙げることなく応力緩和性を向上させること ができ、好都合である。

[0021]

本発明においては、天然ゼオライトや合成ゼオライトを問わず用いることができる。例えば、天然ゼオライトとしてはモルデナイト(モルデン沸石)やエリオナイト(毛沸石)、クリノブチロライト、チャバザイト(斜方沸石)などが挙げられる。合成ゼオライトとしてはA型ゼオライトやX型ゼオライト、Y型ゼオライト、L型ゼオライト、オメガ型ゼオライトなどが挙げられる。また、これらのうちから選ばれた少なくとも1種又は2種以上を混合して用いることができる。

[0022]

また、無機充填剤の粒径としても特に制限されるものではないが、平均粒径 $0.01\sim150\,\mu\,\mathrm{m}$ 、好ましくは $0.5\sim100\,\mu\,\mathrm{m}$ 、さらに望ましくは $0.5\sim35\,\mu\,\mathrm{m}$ のものが好適に用いられる。 $150\,\mu\,\mathrm{m}$ よりも大きな粒径を有する無機充填剤を用いた場合には、分散不良を引き起こし、得られた貼付材用基材フィルムにいわゆるフィッシュ・アイ現象が増加し、好ましくない。

[0023]

さらにA層には熱可塑性エラストマーが添加される。熱可塑性エラストマーを 添加することにより、無機充填剤とポリプロピレン系樹脂との相溶性を高め、貼 付材用基材フィルムの耐衝撃性や延伸性、柔軟性、透明性等の劣化を防止できる

[0024]

このような熱可塑性エラストマーとしては、明確な降伏点を有しない低結晶性 エラストマー又は明確な融点及び明確な降伏点を有しない非晶性エラストマーで

ラストマーなどが挙げられる。

一件法(とう) 静材 たけさい

[0025]

 $IR^{t-s} = v^{t} - v^{t} + v^{t}$

より具体的に言うと、スチレン系エラストマーとして、スチレンーブタジエン 共重合体及びその水素添加物、スチレンーブタジエンースチレン共重合体(SBS)、イソプレンースチレン共重合体及びその水素添加物、水素添加スチレンーイソプレン共重合体(SEPS)、水素添加スチレンービニルイソプレン共重合体(V-SEPS)、スチレンーイソプレンースチレン共重合体(SIS)、水素添加スチレンーイソプレンースチレン共重合体(SIS)、水素添加スチレンーイソプレンースチレン共重合体(SEPS)、水素添加スチレンーブタジエンーオレフィン結晶ブロック共重合体(SEBC)等が挙げられる。

[0026]

また、ポリオレフィン系エラストマーとして、非晶性又は低結晶性ポリオレフィン/αーオレフィン共重合体、例えば、エチレンープロピレン共重合体、エチレンーブテンー1共重合体、ポリオレフィン樹脂とオレフィン系ゴムとの混合物、ポリオレフィン樹脂とオレフィン系樹脂の完全架橋体との混合物等が挙げられる。

[0027]

さらに、ポリエステル系エラストマーとしては、ポリエステルーポリエーテル 共重合体、ポリエステルーポリエステル共重合体等を、また、ポリアミド系エラ ストマーとして、ポリアミドーポリエステル共重合体、ポリアミドーポリエーテ ル共重合体をそれぞれ例示できる。

[0028]

このような熱可塑性エラストマーは、A層の樹脂組成物全重量中 $3\sim50$ 重量%、より好ましくは $5\sim40$ 重量%添加される。また、このとき、無機充填剤などその他の添加剤等をも含めたA層全重量中、 $5\sim30$ 重量%添加される。

[0029]

[0030]

また、当該共重合体としては、プロピレンと共重合できるものであれば特に問われるものではないが、適度な柔軟性を得るためには、エチレンを含有するランダムポリプロピレンを用いるのが特に好ましい。

[0031]

本発明においては、このB層には、上記した熱可塑性エラストマーが含有されたものを用いるのがより好ましい。また、この際、B層の樹脂組成物全重量中3~95重量%、より好ましくは5~80重量%添加される。また、このとき、その他の添加剤等をも含めたB層全重量中、10~50重量%添加される。

[0032]

この熱可塑性エラストマーが含有されたB層は、A層の片面に積層され、2層構造の貼付材用基材フィルムとして、あるいはA層の両面に積層して3層構造の貼付材用基材フィルムとして提供される。特に、A層の少なくとも何れか一方の露出面に、熱可塑性エラストマーを含有したB層が積層され、残るA層の露出面には熱可塑性エラストマーを含有しないB層若しくは熱可塑性エラストマーを含有するB層が積層された3層構造とするのがよい。このような構造の貼付材用基材とすることにより、耐熱性や引張強度、柔軟性並びに応力緩和性において軟質ポリ塩化ビニルフィルムに近い特性を発揮させることができ、粘着剤層を積層した場合に軟質ポリ塩化ビニルフィルムと同様な貼付性を得られるものである。もちろん、A層の何れか一方のみに、熱可塑性エラストマーを含有したB層を積層したり、熱可塑性エラストマーを含有しないB層を積層するのみでも、ある程度引張強度、柔軟性、応力緩和性の向上に寄与できるものである。

[0033]

智序生产 35c for

なお、A層及び/又はB層には、一般的な貼付材用基材フィルムに用いられるような耐熱安定剤、酸化防止剤、光安定剤、帯電防止剤、滑剤、核剤、難燃剤、

本発明においては、上記したように非晶性ポリオレフィンに、各種の無機充填 剤や熱可塑性エラストマーなどが配合されたA層(フィルム)に、ポリプロピレ ン系樹脂に、熱可塑性エラストマーが配合された B層 (フィルム) 若しくは熱可塑性エラストマーが配合されていない B層 (フィルム) が積層されるが、このとき、各層ごとに上記各成分を混合して、通常ペレット状若しくは塊状として供給された後、積層フィルムに加工される。

[0035]

この際、混合方法としても特に限定されるものでもなく、従来から採用されている公知である種々の混合機、例えば、ニーダー、ロール、バンバリーミキサー等の各種混練り機、あるいは、一軸若しくは二軸押出し機等を用いて加熱溶融混練りして、ペレット状等に加工される。

[0036]

そして、これらのペレット等を用いてA層及びB層からなる積層フィルムが形成される。この時の成形方法も特に限定されるものではなく、従来から公知のTダイ法、インフレーション法、カレンダー法、圧延法等により所望する厚みに製膜して積層フィルムにすることができる。もちろん、樹脂ペレットを経ることなく、各層における上記成分を混練りして、ドライブレンド等にてフィルム状に一貫製造することができるのは言うまでもない。

[0037]

また、積層フィルムとする方法としても、従来から用いられている種々の公知の方法を用いることができ、いわゆるA層の片面若しくはその両面にB層をラミネートする方法や、2層若しくは3層共押出し法による方法が採用される。

[0038]

各層の厚みとしては、A層の厚みが $10\sim100\mu$ m、好ましくは $20\sim80\mu$ mであり、B層の厚みとしては、熱可塑性エラストマーを含有するしないにかかわらず、 $2\sim20\mu$ m、好ましくは $3\sim15\mu$ mに設定される。A層の厚みが 10μ mよりも薄いと本発明の効果である応力緩和性が十分に発揮できない場合

3.ここに使くないとき、未軟性に3.15頭目時の選和感が高いう能性がある

[0039]

一方B層の厚みが2μmよりも薄いとA層に用いた樹脂の低分子物質等の表面

- 1 自己スプログラー サルオルまれた野また。

へのブリードによる弊害が懸念されることがある。また、20μmよりも厚いと、弾性率が高くなりすぎて、皮膚貼付時の違和感が出る可能性がある。

[0040]

このようにして作製された貼付材用基材フィルムにおいては、その片面若しくは両面に粘着剤層が形成される。このとき、A層の表面若しくはB層の表面何れにおいて、粘着剤層を形成してもよいが、A層中の低分子量物質のブリードや投錨性を考えた場合には、B層の表面に粘着剤層を形成するのが好ましく、さらに望ましくは熱可塑性エラストマーを含有するB層の表面に粘着剤層を形成するのが、貼付時の違和感を減少させ、若しくは投錨破壊を防ぐ点でより好ましく、塩化ビニルフィルムを用いた場合により近い特性を発揮させることが可能になる。

[0041]

また、粘着剤層を形成するに際し、当該貼付材用基材フィルムに直接粘着剤層 を形成するだけでなく、基材フィルムとの投錨力向上のため、粘着剤層形成面に エンボス加工などを施して形成するのがよい。また、従来からある公知の方法に より、コロナ処理や下塗り剤による前処理を施して間接的に粘着剤層を形成する のが好ましい。

[0042]

当該粘着剤層には、従来から医療用の粘着剤として用いられるものであれば特に限定されることなく、いかなる粘着剤をも用いることができる。当該粘着剤として、例えば、アクリル系粘着剤やゴム系粘着剤、シリコーン系粘着剤を挙げることができる。

[0043]

当該アクリル系粘着剤としては、好ましくは炭素数が1~18、さらに好ましくは炭素数4~12のアルキル基を有する(メタ)アクリル酸アルキルエステルの単独重合体や当該(メタ)アクリル酸アルキルエステルを主成分単量体として

要該的量体と共重なで能が強力・単量なが、 () 重量の () 好きい () () () ()

真量がの範囲で共車行 こしか種共車が体みとした。 ベン

[0044]

上記(メタ)アクリル酸アルキルエステルとしては、ブチルエステル、ヘキシ

ルエステル、オクチルエステル、ノニルエステル、デシルエステル、ラウリルエステル、ステアリルエステルなどが挙げられ、これらのエステル鎖は直鎖状若しくは分岐状のいずれでもよい。

[0045]

また上記エステルと共重合可能な単量体としては、(メタ)アクリル酸やマレイン酸、フマル酸、クロトン酸などのカルボキシル基含有不飽和単量体、(メタ)アクリル酸2ーヒドロキシエチルエステル、(メタ)アクリル酸3ーヒドロキシプロピルエステルなどの(メタ)アクリル酸ヒドロキシアルキルエステル、(メタ)アクリルアミドやジメチル(メタ)アクリルアミド、ジエチル(メタ)アクリルアミドなどの(メタ)アクリルアミド及びその誘導体、Nーブトキシメチル(メタ)アクリルアミド、Nーエトキシメチル(メタ)アクリルアミドなどのNーアルコキシアルキル(メタ)アクリルアミド、(メタ)アクリル酸N、Nージメチルアミノエチルエステルなどの(メタ)アクリル酸N、Nーアルキルアミノアルキルエステル、Nービニルピロリドンなどの酸アミド基含有不飽和単量体などの官能性単量体が挙げられる。なお、これらの官能性単量体以外に、酢酸ビニルやスチレン、アクリロニトリルなどの無官能性の単量体も共重合させることができる。

[0046]

盛が悪たな コンティー とむた

ゴム系粘着剤としては、天然ゴム、ポリイソブチレン、ポリイソプレン、ポリブテン、スチレンーイソプレン系ブロック共重合体、スチレンーブタジエン系ブロック共重合体などの主ポリマーに粘着付与樹脂としてロジン系樹脂やテルペン系樹脂、クマロンーインデン系樹脂、テルペンーフェノール系樹脂、石油系樹脂などを配合したものを用いることができる。さらに必要に応じて、液状ポリブテンや鉱油、ラノリン、液状イソプレン、脂肪酸エステルなどの軟化剤や、酸化チタン、酸化亜鉛などの充填剤、ブチルヒドロキシトルエンなどの酸化防止剤など

(1) "瘀 柏(森)" (1) (1) (2) (3) (5)

ましい。

[0047]

シリコーン系粘着剤としては、ジメチルポリシロキサンを主成分とする粘着剤 が例示される。

[0048]

これらの粘着剤から構成される粘着剤層の厚みは、10~120μmが好ましく、さらに好ましくは20~80μmである。10μmより薄いと、貼付材として皮膚に適用した場合、十分な固定性が得られないことがある。また、120μmよりも厚いと貼付材として皮膚に適用後剥離時に、粘着力が強過ぎてかぶれを引き起こす懸念がある。また、過剰の糊厚のためコスト的にも不利となる。これらの粘着剤は、従来から公知の方法によって上記基材フィルム上に塗布され、粘着剤層が形成される。

[0049]

このようにして得られた本発明に係る貼付材は、例えば、ロール状に巻回され 、いわゆる巻絆創膏(サージカルテープ)として用いられる。

[0050]

また、適当な大きさに切断した後、粘着剤層の表面中央領域に吸液性のパッドを備え、救急絆創膏として用いることもできる。当該吸液性パッドとしては、従来から使用されている公知のものが用いられ、例えば、ガーゼや織布、不織布、脱脂綿と不織布との複合品、脱脂綿と編ネットとの複合品などを挙げることができる。また、その大きさは貼付材の大きさによっても異なるが、吸液性パッドの周囲に該貼付材の粘着剤層が少なくとも2~3mm程度露出されるような大きさに調整するのが好ましい。

[0051]

[0052]

このようにして得られた貼付材は、柔軟性や応力緩和性に優れ、貼付感の良好なものであるが、皮膚面に長時間貼付すると貼付部位にムレを生じ、その結果、皮膚かぶれを引き起こしたり恐れがある。従って、このような場合には、貼付材用基材フィルム及び粘着剤層に、機械的強度を低下させない程度に穿孔処理を施すことが好ましい。この穿孔処理により、本発明の巻回された絆創膏においては、使用時の手切れ性が付与される。なお、これらの穿孔処理を施すには、穿孔ロールによる方法や、パンチング、レーザー照射などの方法を用いることができ、孔径は0.2~3mm程度とするのが好ましい。

[0053]

【実施例】

以下、各実施例に基づいて、本発明についてさらに詳細に説明する。なお、以下における「部」は「重量部」を意味し、「%」とは「重量%」を意味する。

[0054]

<樹脂ペレットの作製>

A層に用いる樹脂については、160℃のニーダーにて非晶性ポリオレフィン 樹脂、無機充填剤、熱可塑性エラストマーを表1に示すように所定量仕込み、5 ~10分間混練りして必要とする樹脂ペレットを作製した。またB層に用いる樹 脂についても、160℃のニーダーにてランダムポリプロピレン及び熱可塑性エ ラストマーを表2に示すように所定量仕込み、5~10分間混練りして必要とす る樹脂ペレットを作製した。

[0055]

【表1】

A層の組成

			7 1 12	4 主成分		無機充填剤	[剤	熱可塑性ポリ	1
		重	配合量	種類	配合量	種類	配合量	種類	配合量
<	. —	¥ДР. Р. ИFR: 1	2 5	プロピレン・ ブテンー1共重合体 溶融粘度(190℃) 8000mpa・s	2 5	タルク 粒径5μm	4 0	水添スチレン・ ブタジエン共重合体 MFR:10	10
₹		¥БР. Р. ИFR: 1	2 5	プロピレン・ エチレン共重合体 溶融粘度(190℃) 8500mpa・s	2 5	タ ル ク 粒径 5 μ m	3 0	水添スチレン・ ブタジエン共重合体 MF R: 10	1 0
A	, — —	ЯДР. Р. ИFR: 1	2 0	プロピレン・ ブテンー1共重合体 溶融粘度(190°C) 8000mpa・s	3.0	ゼオライト 粒径2.8μm	4 0	エチレン・ ブテン- 1 共重合体 MFR: 3.5	15
- A		¥ДР. Р. ИFR: 1	2 5	プロピレン・ グテン-1 共重合体 溶融粘度(190℃) 8000mpa・s	2 5	タ ル ク 粒径5μm	4 0	水添スチレン・ ブタジエン共重合体 MF R: 1 0	1 0

MFR:メルトフローレイト(230℃、21.18Nの荷重で測定、8/10分)

[0056]

<フィルムの作製>

公知のTダイ法により3層押出し機を用いて、実施例である貼付材用基材フィルムを作製した。この際、各押出し機のシリンダー温度を150~240℃の間となるように、樹脂の種類に応じて適宜調整した。このとき、表2に示すように、各種組成物を所定厚さ比となるように押出し、各層(各フィルム)のトータル厚さが80μmとなるように調整しながら製膜し、実施例1~6の貼付材用基材フィルムを得た。また、得られた貼付材用基材フィルムの両面にエンボス加工を施したが、これは押出し直後冷却前にエンボスロールにて圧着して施した。

[0057]

【表2】

	ĺ
松	
猫	
6	
4	l
7	1
7	I
7	
Þ	Ì
	I
基	ŀ
Щ	
ĮZ.	1
t	
ᇤ	

				路 竹 内 用	あん	1 / /	アセツ的双			
		В	層成	t 分 (粘着剤積層面)		1	B	層成	分(粘着剤非積層面)	(
		K	配合量		配合量	A層成为	ベージ	配合量	熱可塑性ポリマー	配合量
実施例 1		ΔP. P.	7 0	エチレン・ ブテンー 1 共重合体 MF R: 3.5	3.0	A 1	ランダムP. P. MFR:11	100		
実施例 2		ΔP. P.	0 8	水添スチレン・ ブタジエン共 重 合体 MF R: 10	2 0	A 2	ランダムP. P. MFR:11	100		
実施例3		ΔP. P. < : 1 1	0 2		3 0	A 3	ランダムP. P. MFR:11	100		
実施例4		ΔP. P. 2:11	0 8	エチレン・ ブテンー 1 共 重合体 MFR: 3, 5	2 0	A 4	ランダムP. P. MFR:11	8 0	エチレン・ ブテン-1 共重合体 MF R: 3.5	2 0
実施例 5	, ,					A 4	ランダムP. P. MFR:11	1 0 0		
実施例6		ΔP. P. 3:11	1 0 0			4 A				
比較例 1	i					4 A				
比較例2	**	サアン	/エチレ	チレン/エチレン・酢酸ビニル共重合体プレンド	含体ブレン		単層フィルム			
比較例3		× · · · · ·	チルメタ	ン・メチルメタクリレート共重合体	単層フィルム	ルム				
比較例4	12	氧化ビニル		単層フィルム						
膜厚; 実施例	施河	~4:E	:B層/A層/	層/B層=1/10/1=80 (μm)	7) 08=	l	; 実施例5, 6: A層	/B屬=1	$6:A$ 層 /B 層 = $10/1=80$ (μ m)	

~4:B層/A層/B層=1/10/1=80 (μm) ;実施例5,6:A層/B層=10/1=80 (μm) ~4:単層 80μm ; 実施例 比較何

[0058]

<粘着剤の作製>

(粘着剤1)

アクリル酸イソオクチルエステル95部、アクリル酸5部を、重合溶媒として の酢酸エチル中で共重合させ、固形分濃度が35%の粘着剤溶液を得た。

[0059]

(粘着剤2)

上記粘着剤1の100部に対して、可塑剤としてミリスチン酸イソプロピル7 0部、外部架橋剤として3官能性ポリイソシアネート0.2部を酢酸エチルに希 駅して、固形分濃度が30%の粘着剤溶液を得た。

[0060]

<貼付材の作製>

片面をシリコーン樹脂で剥離処理したセパレータ上に、上記作製した粘着剤溶液を乾燥後の厚みが約50μmとなるように塗布、乾燥して粘着剤層を作製した。次に、得られた粘着剤層を実施例1~6の貼付材用基材フィルムに転写積層して、各種の貼付材を作製した。

[0061]

<評価試験>

上記のようにして作製した貼付材用基材フィルム及び貼付材を用い、以下に示す項目について評価試験を行なった。なお、試験用のサンプルとして、上記各フィルムを幅20mm、長さ40mmの大きさに裁断したものを用いた。また、測定には、貼付試験を除き、引張試験機を用いてチャック間距離20mm、23±2℃、65±15%相対湿度の条件下で行なった。さらに、比較例として、表2に示す各種単層基材フィルムを用いて同様に試験を行なった。

[0062]

をは併出け さ

[0063]

(応力緩和比)

初期応力と同様にして引張試験を行い、10%伸びまで延伸して、時間経過による引張応力値の変化を測定し、次式により応力緩和比(%)を求めた。

応力緩和比(%)=(5分後応力/初期引張応力)×100

なお、初期引張応力は、引張開始直後から10%伸長するまでの最大引張応力 値を示す。

[0064]

(応力半減時間)

初期応力と同様にして引張試験を行い、10%伸びまで延伸して、時間経過による引張応力の変化を測定し、応力緩和曲線を求めた。この曲線より初期引張応力が、半分になるまでの時間(秒)を求めた。これらの基材フィルムの特性を表3にまとめた。

[0065]

(貼付材の貼付性)

上記実施例1~4及び比較例2~4の貼付材用基材フィルムを用いた貼付材を、それぞれ5cm×5cmの大きさに裁断して、健常人ボランティア10名の肘(屈曲部)に8時間貼付してもらい、貼付感、皮膚接着性について5段階評価により評価した。その結果を表4に示す。なお、表4には10名の平均値を示した

[0066]

(チューブ固定性)

上記実施例1,4,5,6及び比較例1の貼付材用基材フィルムを用いたサージカルテープを、それぞれ12mm×60mmの大きさに裁断し、健常人ボランティア10名の前腕内側に当該テープでもって、外径5mmのシリコーンチューブをU字型にしたものを固定し、その時の固定性をチューブの復元力により剥が

10001

(救急絆創膏の貼付性)

上記実施例1,2,4及び比較例2~4の貼付材用基材フィルムを用いた貼付

1 to 1 to 1 to 1 to 1

材を、それぞれ19mm×72mmの大きさに裁断し、粘着剤表面の中央領域に 12mm×20mmの大きさのガーゼパッドを設けて、救急絆創膏を作製した。 得られた救急絆創膏を、健常人ボランティア10名の指第2関節に6時間ラップ 巻すると共に前腕部に8時間貼付してもらい、貼付感、皮膚接着性、皮膚刺激性 について5段階評価により評価した。その結果を表6に示す。なお、表6には1 0名の平均値を示した。

[0068]

<評価結果>

まず表3から分かるように、本発明による貼付材用基材フィルムにおいては、 従来のポリエチレン系フィルムに比べて、初期応力はほぼ同等若しくはそれより も高いものの、実際の使用上は特に問題となるものではなかった。しかし、応力 緩和比については、従来のポリエチレン系フィルムに比べて低く、塩化ビニル製 フィルムに近い値が得られた。また、応力半減時間においても、塩化ビニル製フ ィルムほどには短くならなかったが、従来のポリエチレン系フィルムに比べれば 、格段に短いものであった。

[0069]

次に、これらの貼付材用基材フィルムを用いて各種貼付材を得たところ、表4 及び表6から分かるように、従来のポリエチレン系フィルムに比べて、貼付感、 皮膚接着性及び皮膚刺激性においても良好なものが得られ、また、塩化ビニルフィルムを用いた場合とほぼ同様な貼付性能を得られることが分かった。

[0070]

また、非晶性ポリオレフィンよりなるA層に直接粘着剤層を積層した場合には、表5に示すように粘着剤によっては投錨破壊が見られ、復元力の強いチューブの固定性に十分適したものが得られなかった(実施例5及び比較例1)。

[0071]

たっない。 なんののの では、 これのの の では、 これの では で で は を で かけ かったい なんの の の で で いっという の の 定性 で で かったい かけいか ることが分かった。

[0072]

【表3】

基材フィルムの特性試験結果

基材 フィルム	初期応力 (N/20mm)	応力緩和比 (%)	応力半 減 時間 (s)
実施例1	13.8	3 6	1 6
実施例2	13.6	3 9	2 9
実施例3	11.7	3 5	1 4
実施例4	13.0	3 6	1 6
比較例 2	11.9	6 7	500以上
比較例3	7. 5	6 5	500以上
比較例 4	8. 5	1 7	2

[0073]

【表4】

貼付材の貼付試験結果

基材 フィルム	粘 着 剤	貼 付 感	皮膚接着性
実施例 1	1	4. 5	4. 2
実施例 2	1	4. 4	4. 6
実施例 3	1	4.8	4. 7
実施例 4	1	4. 6	4. 5
比較例 2	1	3. 7	4. 1
比較例 3	1	3. 5	4.3
比較例 4	1	4. 7	3.5

評価:5 (良好) -4-3 (普通) -2-1 (悪い)

[0074]

【表5】

チューブ 固 定 性 試 験 結 果

基 材 フィルム	粘	着	剤	固	定	性
実施例 1		2		18	0分	以上
実施例 4		2		18	0分	以上
実施例 5		2			*	
実施例 6		2		18	0分	以上
比較例 1		2			*	

^{*}試験冷中で粘着剤が投錨破壊

【表 6】

救急 維創膏の貼付試験結果

基材	粘着剤	貼作	寸 感	皮膚	接着性	皮膚 刺激性
フィルム	76 6 713	指	前腕	指	前腕	前腕
実施例1	1	4. 2	4. 3	4. 5	4. 7	4.3
実施例2	1	4. 5	4. 7	4. 3	4. 3	4.0
実施例4	1	4. 7	4.8	4. 2	4. 6	4.3
比較例2	1	3.8	4. 1	3. 8	4. 5	3. 9
比較例3	1	3. 7	4. 3	4. 1	4. 2	3.5
比較例4	1	4. 5	4.8	4. 5	4. 7	4. 1

評価:5 (良好) -4-3 (普通) -2-1 (悪い)

[0076]

【発明の効果】

本発明の貼付材用基材フィルムによれば、非晶性ポリオレフィンよりなるA層の少なくとも片面に、ポリプロピレン系樹脂よりなるB層を積層しているので、従来のポリオレフィンフィルムに比べて、引張強度、柔軟性並びに応力緩和性においてバランスのとれたポリ塩化ビニルフィルムの特性に近い基材フィルムを提供できる。

[0077]

このとき、A層に積層されるB層に、熱可塑性エラストマーを含有させることにより、より一層引張強度、柔軟性並びに応力緩和性などの特性を塩化ビニルフィルムのそれに近づけることができる。

に熱可塑性エラストマーを含有させることにより、より貼付性能に優れた貼付材 を提供できる。また、熱可塑性エラストマーを含有させたB層に、粘着剤層を形

特2000-119987

成することにより、投錨破壊が少なく、また、A層中に含有された低分子量物質が粘着剤層に移行してブリードを生じるのを防ぐことができるのは言うまでもない。

[0079]

このように本発明によれば、従来の塩化ビニルフィルムの代替となる貼付材用 基材フィルムを提供でき、本発明に係る貼付材用基材フィルムを用いることにより、引張強度、柔軟性並びに応力緩和性において優れ、塩化ビニルフィルムを用いた場合と劣ることのない絆創膏、救急絆創膏などの各種医療用途に適した貼付材を提供できる。

特2000-119987

【書類名】

要約書

【要約】

【目的】 引張強度、柔軟性並びに応力緩和性などにおいてバランスのとれた特性を有する軟質ポリ塩化ビニルフィルムの代替となる新たな貼付材用基材フィルム及びこれを用いた貼付材、絆創膏並びに救急絆創膏を提供する。

【構成】 例えば、非晶性ポリプロピレン、エチレン及び/又はブテン-1とプロピレンとのランダム共重合体などの非晶性(低結晶性)ポリオレフィンよりなるA層の片面若しくはその両面に、ランダムポリプロピレンなどのプロピレンを主成分とする共重合物よりなるB層を積層して、貼付材用基材フィルムを得る。また、A層には、エチレンーブテン共重合体及び/又はスチレンーブタジエン共重合体などの熱可塑性エラストマー及び無機充填剤を配合する。さらに、B層にも、前記熱可塑性エラストマーを配合する。こうして得られた貼付材用基材フィルムの好ましくは熱可塑性エラストマーを含有するB層露出面に粘着剤層を積層して、貼付材を得る。

【選択図】 なし

認定・付加情報

特許出願の番号

特願2000-119987

受付番号

50000503191

書類名

特許願

担当官

第五担当上席 0094

作成日

平成12年 4月21日

<認定情報・付加情報>

【提出日】

平成12年 4月20日

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[000003964]

1. 変更年月日 1990年 8月31日

[変更理由] 新規登録

住 所 大阪府茨木市下穂積1丁目1番2号

氏 名 日東電工株式会社